

日月光九十八年度第三季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 98 年 10 月 30 日同步於美國及台灣兩地發佈九十八年度第三季獲利報告，本公司九十八年第三季之合併營業收入較第二季成長 21%，較九十七年同期衰退 2%，為新台幣 25,205 百萬元。茲將日月光九十八年度第三季單季及前三季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

表(一)簡明營運成果分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	98 年度 第三季	98 年度 第二季	97 年度 第三季	98 年度 前三季	97 年度 前三季
營業收入	25,205	20,881	25,815	59,483	76,119
營業毛利	6,357	4,524	6,431	11,539	18,833
營業淨利(淨損)	3,967	2,496	3,715	5,052	10,493
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	3,857	2,206	3,154	4,416	9,999
所得稅利益(費用)	(558)	(559)	(777)	(1,066)	(1,968)
少數股權純損(益)	(112)	27	(165)	(55)	(1,071)
本期淨利(淨損)	3,187	1,674	2,212	3,295	6,960
稀釋每股盈餘(元)	0.61	0.32	0.41	0.63	1.26

表(二)整體業務之產品結構及客戶組成

產 品 項 目	占營收比率(%)
通訊產品	44
個人電腦	17
汽車及消費性電子產品	37
其他	2
前十大客戶佔營收比重	42

表(三)銷售地區分析

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	52
歐洲	13
台灣	20
日本	10
亞洲其他地區	5

表(四)封裝業務

產 品 組 合	占營收比率(%)
Advanced substrate & leadframe based	88
Traditional leadframe based	6
Module assembly	3
Others	3
封裝資本支出金額	91 百萬美元
打線機台數	8,880

表(五)測試業務

產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	82
晶圓測試	15
前段測試	3
測試資本支出金額	17 百萬美元
測試機台數	1,569